

目录

1 范围	1	3.5.2 间距	3
1.1 范围	1	3.5.3 导电表面	3
1.2 目的	1	3.5.4 缺口和针孔	3
1.3 性能等级	1	3.6 结构完整性	3
1.4 埋入无源器件分类	1	3.6.1 热应力	3
1.5 文件分级	1	3.6.2 显微切片完整性	4
1.6 采购选择	1	3.7 保护性覆盖	4
1.7 选择（默认）	1	3.7.1 阻焊膜覆盖要求	4
1.8 术语和定义	1	3.7.2 其他保护性涂层	4
1.8.1 由供需双方协商确定（AABUS）	1	3.8 电气要求	4
2 适用文件	1	3.8.1 埋入无源器件印制板的电气要求	4
2.1 IPC	1	3.8.2 介质耐压	4
2.2 美国安全检测实验室	2	3.8.3 电路	5
3 要求	2	3.8.4 湿热及绝缘电阻（MIR）	5
3.1 总则	2	3.9 清洁度	5
3.2 材料	2	3.10 特殊要求	5
3.2.1 刚性层压板	2	3.10.1 热损耗	5
3.2.2 挠性薄膜	2	3.10.2 热冲击	5
3.2.3 微波高速材料	2	3.11 维修	5
3.2.4 粘结材料	2	4 质量保证条款	5
3.2.5 电阻材料	2	4.1 总则	5
3.2.6 电容和电容材料	2	4.2 验收测试	5
3.2.7 金属箔	3	4.2.1 C=0 零验收数抽样方案	5
3.2.8 金属镀层和涂层	3	4.2.2 仲裁测试	5
3.2.9 阻焊膜	3		
3.2.10 埋入无源器件聚合物涂层	3	表	
3.2.11 标记油墨	3	表 3-1 埋入无源器件成品印制板公差要求	4
3.2.12 其他材料	3	表 3-2 介质耐压	4
3.3 目视检查	3	表 4-1 C=0 抽样方案（特定指数值对应的样本量）	6
3.4 印制板尺寸要求	3	表 4-2 接收检验及频次	6
3.5 埋入无源器件图形精度	3		
3.5.1 尺寸验证	3		